

「標準マイクロソルダリング技術 第4版」(ISBN : 978-4-526-08328-0 ・ 1 刷)

正誤表

本書内に下記の誤りがありました。お詫びして訂正します。

ページ	箇所	訂正箇所とその説明
v	1.4.2 項 タイトル	誤：1.4.2 <u>インナー</u> ボンディング 正：1.4.2 半導体チップ のボンディング
12	左段下から 17 行目 (1.4.1 項 1 行目)	誤：ダイボンディングは <u>チップ</u> をリードフレームのダイパッドや基板に 正：ダイボンディングは 半導体チップ をリードフレームのダイパッドや基板に
12	右段下から 11 行目 (1.4.2 項 項目名)	誤：1.4.2 <u>インナー</u> ボンディング 正：1.4.2 半導体チップ のボンディング
12	右段下から 8 行目 (1.4.2 項 3 行目)	誤：この <u>接続</u> はインナーボンディングと呼称される。インナーボンディングの主な形態としてワイヤボンディング、フリップチップボンディング、 正：この <u>接続方法</u> には、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング、
13	左段 3 行目	誤：チップ上の電極と 正： 半導体チップ 上の電極と
15	左段 10 行目	誤：チップのパンプ径は数十 μm であり、 正： 半導体チップ のパンプ径は数十 μm であり、
15	右段下から 19 行目	誤： <u>インナーボンディングの後に</u> 半導体チップおよびインナーボンディング部を保護するために封止する。 正：半導体チップおよびボンディング部を保護するために封止する。 (※「インナーボンディングの後に」を削除)
15	右段下から 7 行目	誤：まず、金型のキャビティと呼称される成形部に <u>インナーボンディング</u> 後のリードフレームや基板などを、 正：まず、金型のキャビティと呼称される成形部に ボンディング 後のリードフレームや基板などを、
32	式 (2.3.10) 右辺	誤： $c \rho V \frac{dT}{dt}$ 正： $-c \rho V \frac{dT}{dt}$
69	左段 11 行目	誤：カーケン <u>ダル</u> ボイド 正：カーケ <u>ンドール</u> ボイド
71	右段 6 行目	誤：浸 <u>透</u> 正：浸 <u>せき</u>
73	左段 12 行目	誤： <u>比重 (単位体積あたりの質量)</u> 評価方法としては 正：評価方法としては (※「比重 (単位体積あたりの質量)」を削除)
73	図 4.4.5 図中	誤： d_2 正： t_2

ページ	箇所	訂正箇所とその説明
73	右段下から 2 行目 式(4.4.3)	誤： $\sqrt{1+3(\cot \theta/2)^2}$ 正： $\sqrt[3]{1+3(\cot \theta/2)^2}$
81	左段下から 2 行目	誤： θ は大きくなり 正： θ は小さくなり
82	左段 4 行目	誤： <u>ロジン系</u> や樹脂系の 正：樹脂系の (※「ロジン系や」を削除)
88	図 5.5.1 図中「搭載工法」の 下から 3 つ目の囲み	誤：導電性接着剤－半導体集積回路－フリップチップ（ <u>後</u> 入れ）－ACF/ACP 正：導電性接着剤－半導体集積回路－フリップチップ（ <u>先</u> 入れ）－ACF/ACP
93	左段 7 行目	誤：Sn-3A%g-0.5%Cu 正：Sn-3%Ag-0.5%Cu
123	図 7.1.1	誤：浸せき方式（ <u>ディップソルダーリング</u> ） 正：浸せき方式 (※「(ディップソルダーリング)」を削除)
123	図 7.1.1	誤：抵抗方式（ <u>ヒータ方式</u> ） 正：抵抗方式 (※「(ヒータ方式)」を削除)
123	図 7.1.1	誤：赤外線輻射熱および対流加熱によるソルダーリング方式 正：赤外線輻射熱によるソルダーリング方式 (※「および対流加熱」を削除)
127	左段 8 行目	誤：液濃度の <u>厳密な</u> 比重管理 正：液濃度を <u>厳密に管理するための</u> フラックスの比重管理
127	右段 21 行目 (下から 12 行目)	誤：特にプリント配線板とソルダが離れるとき（ピールバック時）の噴流ウェーブの形状が 重要で、 <u>リアフォーマの角度、形状等に依存するところが大きい。</u> 正：特にプリント配線板とソルダが離れるとき（ピールバック時）の噴流ウェーブの形状が 重要である。
127	右段下から 6 行目	誤： <u>第</u> 二次ウェーブ 正：二次ウェーブ (※「第」を削除)
134	左段 12 行目	誤：抜け性 正： <u>版</u> 抜け性
136	右段 12 行目	誤：VPS（凝集ソルダーリング <u>方式</u> ） 正：VPS（凝集ソルダーリング） <u>方式</u>
138	左段下から 2 行目	誤：リフローにおける 正：リフロー <u>ソルダーリング</u> における
141	右段 3 行目	誤：熱伝達によってソルダーリングする方式 正：熱伝 <u>導</u> によってソルダーリングする方式

ページ	箇所	訂正箇所とその説明
145	右段 1 行目	誤：疲労破壊 正： 熱 疲労破壊
155	右段 19 行目	誤：局所溶ダリング <u>(部分フロー)</u> 正：局所溶ダリング (※「(部分フロー)」を削除)
156	左段 15 行目 (下から 7 行目)	誤：はんだ 正：溶ダ
162	左段 7 行目 (下から 2 行目)	誤： <u>第</u> 二次噴流 正：二次噴流 (※「第」を削除)
190	左段下から 6 行目	誤：カーケン <u>ダル</u> ボイド 正：カーケン <u>ドール</u> ボイド
213	右段 4 行目	誤： <u>常時</u> 各作業場 正：各作業場 (※「常時」を削除)
224	左段上から 2 行目:	誤：カーケンダルボイド……69 正： 削除